

武汉力源信息技术股份有限公司

关于公司为全资子公司（孙）公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足全资子公司（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月8日、3月25日召开董事会、股东大会审议通过《关于2024年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币20.80亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于2024年3月9日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容

在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与华夏银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司洪山支行签订了《保证合同》，其中为全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（以下简称“力源应用”）向华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供1000万元担保，为全资子公司武汉芯源半导体有限公司（以下简称“芯源半导体”）向华夏银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司洪山支行申请综合授信分别提供1000万元担保。同时，力源应用、芯源半导体均对公司提供了等值的反担保。

1、公司为力源应用提供担保签订的担保协议主要内容

为力源应用向华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供担保的协议

- ①担保事项：债务人在银行办理主合同项下约定业务所形成的债权
- ②担保方式：连带责任保证
- ③担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
- ④担保金额：1000万元

2、公司为芯源半导体提供担保签订的担保协议主要内容

(1) 为芯源半导体向华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供担保的协议

①担保事项：债务人在银行办理主合同项下约定业务所形成的债权

②担保方式：连带责任保证

③担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年

④担保金额：1000万元

(2) 为芯源半导体向汉口银行股份有限公司洪山支行申请综合授信提供担保的协议

①担保事项：债务人在主合同项下享有的所有债权

②担保方式：连带责任保证

③担保期间：保证期间为三年，自被担保债务的履行期届满之日起算，被担保债务的履行期依照主合同的相关约定确定

④担保金额：1000万元

三、累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币 4.98 亿元（均系公司为全资子公司（孙）公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.01%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

1、公司与银行签订的《保证合同》；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 30 日